

证券代码：002636

证券简称：金安国纪



**金安国纪集团股份有限公司**

**Goldenmax International Group Ltd.**

（上海市松江工业区宝胜路 33 号）

**2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资  
金使用的可行性分析报告  
（修订稿）**

二〇二六年二月

一、本次募集资金的使用计划

金安国纪集团股份有限公司（以下简称“公司”或“金安国纪”）2025 年度向特定对象发行股票（以下简称“本次发行”）募集资金总额不超过人民币 129,995.39 万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于以下项目：

单位：万元

项目名称	项目投资总额	扣减前拟使用募 集资金金额	扣减金额	扣减后拟使用募 集资金金额
年产 4,000 万平方米高 等级覆铜板项目	150,105.78	125,000.00	4.61	124,995.39
研发中心建设项目	5,562.17	5,000.00	-	5,000.00
合计	155,667.95	130,000.00	4.61	129,995.39

注：上述募集资金扣减金额包含：本次发行董事会决议日前六个月至本次发行前新投入财务性投资金额为 4.61 万元，公司按照相关规定将其于本次募集资金的总额中调减，扣减金额为 4.61 万元。

在本次发行募集资金到位前，公司可根据募集资金投资项目的实际情况，以自有或自筹资金先行投入，并在募集资金到位后按照相关法律、法规规定的程序予以置换。募集资金到位后，若扣除发行费用后的实际募集资金净额少于拟投入募集资金总额，在本次发行募集资金投资项目范围内，公司将根据实际募集资金数额，对上述项目的募集资金投入顺序和金额进行适当调整，募集资金不足部分由公司自有或自筹资金解决。

二、本次募集资金投资项目的可行性分析

（一）年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目

1、项目概况

公司拟投资建设年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目，重点布局高频高速覆铜板、耐高温特种覆铜板、高 Tg 覆铜板及无卤无铅 FR-4 等高性能、特殊性能产品线，同步配置部分产能用于通用型 FR-4 覆铜板生产。项目产品对接多维市场需求，高度契合国家战略发展方向。

覆铜板作为电子工业的基础材料，几乎是所有电子类产品的承载，是被誉为“电子产品之母”的 PCB 的核心材料。从工业电子、工业自动化、工业机器人到消费电子等应用领域的稳步增长与持续升级需求，到 5G/6G 通信设备迭代、新能源汽车电子化、AI 服务器集群等高端应用领域快速扩容，以及全球新能源发电及储能领域投资规模持续扩大，乃至逐步增长的人形机器人、低空经济、空天产业等新兴增量市场的拓展，覆铜板始终是产业链中不可或缺的关键基础材料。

同时，项目实施深度契合“十五五”规划建议中关于科技发展的目标要求，同时受益于规划建议中提振消费举措带来的良好市场前景。通过本项目落地，公司将加速高性能覆铜板领域的技术突破与产能扩张，持续强化行业价值链竞争优势，为电子信息产业升级提供关键基础材料支撑。

## 2、项目实施的必要性

### （1）面向行业发展需求，强化公司可持续增长能力

当前，电子信息产业长期增长逻辑清晰，核心驱动源自 AI 技术深度融合应用、新能源汽车及自动驾驶产业化提速、通信技术代际跃迁（5G-A/6G 演进）及消费电子智能终端功能迭代升级。作为上述应用场景的关键基础材料，高性能覆铜板需求呈确定性增长，将持续驱动行业扩容并加速市场格局重构。

本项目投产后，公司将基于自主技术积淀，满足产业升级需求，加快高性能覆铜板产品产业化进程，推进高性能材料对传统产品的补充升级，实现业务结构优化与价值提升。通过技术创新与国家战略政策的双向赋能，提升公司核心竞争力及长期发展韧性。

### （2）适应市场与竞争需求，提升产能，巩固市场地位

覆铜板行业竞争持续加剧，消费电子与 AI 终端、新能源汽车、通讯与数据中心、工业控制、新能源发电及储能等终端领域客户对产业链上系列产品品质、成本控制及交付效率的要求显著提升。本项目通过引入高自动化、高生产效率的生产线，将有效扩充优质产能，优化生产资源配置，强化规模效应，进而降低综合制造成本，提升产品性价比与交付响应能力。此举旨在增强公司市场竞争力，匹配下游客户需求变化，巩固并提升公司在行业中的市场地位。

### 3、项目实施的可行性

#### （1）国家政策支持，行业发展符合相关产业政策

本项目的实施，具备充分的政策依据和良好的产业环境，与国家关于电子信息制造业和未来产业创新发展的战略方向高度契合。

工信部和市场监督管理总局颁布的《电子信息制造业 2025-2026 年稳增长行动方案》明确将电子信息制造业作为国家战略性、基础性、先导性产业，提出推动产业高端化、智能化、绿色化发展，强化核心技术攻关，提升产业链供应链韧性与安全水平，促进产品向高端化、智能化迈进。本项目直接受益于国家在技术攻关、产业链补链强链及市场拓展等方面的政策支持。

本项目紧密围绕国家电子信息制造业稳增长与未来产业创新发展主线，符合国家战略需求和产业政策方向，具备显著的政策适应性与实施可行性，有助于企业提升核心竞争力，实现高质量发展。

#### （2）公司拥有技术沉淀及研发能力

公司在覆铜板领域深耕多年，依托自主创新构建了深厚的技术积淀与研发实力。研发团队始终贯彻技术引领、绿色低碳及人才为本的发展理念，培养了一支专业扎实、经验丰富且富有创新活力的技术队伍，秉持“贴近市场、创新不止”的宗旨，成功研发出适应市场需求、具备强劲竞争力的产品，拥有了先进的工艺设计和改进能力，截至 2025 年 9 月末，公司累计获得授权的境内专利 246 项，境外专利 7 项，境内专利中发明专利 68 项，实用新型专利 173 项，外观设计 5 项。

#### （3）公司拥有广泛的客户基础，产品具有较好的市场前景

公司恪守诚信经营理念，依法合规稳健发展，凭借长期积累的市场信誉，与客户建立了稳固互信的合作关系。通过持续强化质量管理体系与品牌建设，公司以优质产品与服务赢得市场认可，有效提升客户黏性与品牌影响力，为可持续发展奠定坚实基础。

公司实施多品牌差异化战略：“国纪”品牌聚焦通用市场，提供高性价比、功能适配的标准化产品；“金安”品牌深耕细分领域，专注高性能、定制化特种

材料解决方案。双品牌矩阵覆盖全场景应用需求，构建了多元稳定的客户结构，形成了显著的抗风险能力与发展韧性，持续巩固公司在覆铜板行业的市场地位。

（4）高端市场潜力显著

我国虽为全球最大覆铜板生产国，但高端产品仍依赖进口，市场主要由美日韩及中国台湾厂商主导。据海关总署数据，2024 年以来我国覆铜板进出口均价持续上涨，2024 年和 2025 年 1-9 月，进口金额分别为 112,183.36 万美元、107,072.71 万美元，进口均价分别为 2.76 万美元/吨、3.53 万美元/吨；同期，出口金额分别为 62,604.52 万美元、53,860.38 万美元，出口均价分别为 0.64 万美元、0.80 万美元/吨，凸显高端产品供需缺口。

4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为金安国纪科技（安徽）有限公司，系上市公司的全资子公司。项目实施地点位于安徽省宁国市。本项目总投资 150,105.78 万元，拟使用募集资金 124,995.39 万元，具体项目投资构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	工程费用	115,709.93	97,743.16
1.1	建筑工程费	16,580.20	14,005.72
1.2	软硬件设备购置费	94,409.27	79,749.94
1.3	安装费	4,720.46	3,987.49
2	工程建设其他费用	2,666.23	2,252.23
3	预备费	5,841.41	5,000.00
4	铺底流动资金	25,888.22	20,000.00
总投资合计		150,105.78	124,995.39

5、项目的经济效益评价

本项目顺利实施后，预计具有良好的经济效益。

6、项目涉及的政府报批情况

本项目已于 2025 年 11 月 11 日在安徽省宁国市经济技术开发区管理委员会备案（项目代码：2510-341862-04-01-278669），于 2026 年 1 月 16 日取得宣城

市宁国市生态环境分局出具的《关于金安国纪科技（安徽）有限公司年产 4000 万平方米高等级覆铜板项目环境影响报告表的复函》（宁环审批【2026】4 号），于 2026 年 1 月 26 日取得安徽省发改委出具的《安徽省发展改革委关于金安国纪科技（安徽）有限公司年产 4000 万平方米高等级覆铜板项目节能报告的审查意见》（皖发改能评【2026】8 号），原则同意本项目节能报告。

## （二）研发中心建设项目

### 1、项目概况

伴随业务规模持续扩张与行业竞争加剧，为优化客户资源配置、强化新产品研发能力以满足战略发展需求，公司拟基于安徽宁国工厂现有研发设施基础，增设先进研发及精密检测设备，并联动本地工厂高度自动化、智能化的生产设施，构建高效的新产品性能验证体系，显著提升研发迭代效率与技术成果转化能力。借鉴上海公司市级企业研发中心建设经验，安徽宁国研发中心将力争成为安徽省级企业研发中心项目。本项目建设将基于现有研发方向，持续强化公司在新产品、新工艺、新技术领域的研究，同时面向行业发展方向，在前沿技术领域进行探究，不断创新，支持高品质、高性价比、创新产品的产业化落地。

### 2、项目实施的必要性

#### （1）面向新产品、新工艺、新技术，提升公司研发实力

覆铜板作为电子工业的基础材料，几乎是所有电子类产品的承载基础，俗称电子工业的地皮。它也是产业链中不可或缺的关键基础材料。近年来，国家、产业政策推动制造业高端化、智能化、绿色化发展，消费电子与 AI 终端、新能源汽车、新能源与储能，通讯与数据中心、工业电子、工业机器人等终端行业领域快速发展，日新月异，并呈现多样化、集成化、智能化趋势，对覆铜板产品均提出了更高的标准要求，如新一代通信技术对高频高速覆铜板的低损耗、高稳定性要求；新能源汽车渗透率稳步提升，车载电子系统（如智能驾驶芯片、电池管理系统等）的集成化发展推动了对高导热、高耐压覆铜板的要求；人工智能产业爆发式发展带动服务器、算力芯片等硬件设备迭代升级，高性能计算场景对覆铜板的电气性能与可靠性提出了更高标准。公司只有不断增强自身研发实力，持续在

新产品、新工艺、新技术层面增加研发投入，并对行业发展前沿领域进行探究，才能更好满足客户需求，顺应行业发展趋势。本项目通过增配先进实验仪器及中试验证线，将系统性补强高端技术攻关能力，为突破行业关键共性技术壁垒提供核心支撑。

## （2）构建技术壁垒，提升产品竞争力

当前传统覆铜板市场竞争激烈，行业整体毛利率持续承压，研发中心建设项目通过新产品、新工艺、新技术研发，形成自主知识产权，构建行业技术壁垒，减少对中低端市场的依赖，从“成本竞争”转向“技术竞争”，提升长期盈利稳定性。

## 3、项目实施的可行性

### （1）雄厚的研发实力

公司深耕覆铜板领域多年，系统掌握了覆铜板产品工艺核心技术，从产品到提升设备生产效率均有所布局，为技术攻坚奠定一定基础。公司持续强化创新驱动，秉持科技引领、绿色低碳发展理念，培育了一支专业精深、经验丰富、创新力强的核心技术团队，构建了覆盖研发、生产至销售的全链条核心能力。

### （2）健全的研发体系

公司坚持技术创新战略核心地位，持续完善研发体系与激励机制，对接市场需求，系统推进新产品、新技术及新工艺研发与成果转化。现公司已构建全流程研发管理制度体系，通过标准化流程规范管理，科学配置研发资源，保障项目高效实施，实现研发工作高度管控、规范核算与有效监督。

## 4、项目实施主体与投资概算

本项目实施主体为金安国纪科技（安徽）有限公司，系上市公司的全资子公司。项目实施地点位于安徽省宁国市。本项目总投资 5,562.17 万元，拟使用募集资金 5,000.00 万元，具体项目投资构成如下：

单位：万元

序号	项目名称	投资总额	拟使用募集资金额
1	工程费用	5,277.30	5,000.00
1.1	设备及软件购置费	5,026.00	5,000.00
1.2	安装费	251.30	-
2	工程建设其他费用	20.00	-
3	预备费	264.87	-
总投资合计		5,562.17	5,000.00

### 5、项目的经济效益评价

本项目为公司研发中心建设，不涉及经济效益评价。

### 6、项目涉及的政府报批情况

截至本报告出具日，本项目已于 2025 年 12 月 29 日在安徽省宁国市经济技术开发区管理委员会备案（项目代码：2512-341881-04-01-193680），不涉及环评手续。

## 三、本次发行对公司经营管理和财务状况的影响

### （一）本次发行对公司经营管理的影响

本次募集资金将专项用于年产 4,000 万平方米高等级覆铜板项目及研发中心建设项目，项目紧密围绕公司主营业务实施，不涉及业务方向重大调整。本次募投项目聚焦高端制造领域，与国家产业政策导向及公司战略规划高度契合，有助于加强公司的竞争优势，具备显著的市场前景与经济效益。

项目建成后，公司将通过产能扩充与技术能力提升，进一步扩大市场份额，深化重点业务布局，有效增强盈利能力与市场竞争力。同时，募投规划紧密衔接市场需求与行业趋势，符合产业升级方向，有利于公司发挥规模化优势，全面提升综合竞争实力与抗风险能力，契合公司长期发展战略及股东价值最大化目标。

### （二）本次发行对公司财务状况的影响

本次发行完成后，公司总资产与净资产规模将显著提升，资金实力进一步增强，资产负债结构持续优化，财务风险抵御能力增强，为长期可持续发展奠定坚实基础。



受募投项目效益释放周期影响，本次发行完成后，短期内公司总股本扩大将导致每股收益摊薄。但伴随募集资金到位，公司主营业务发展将获得长期资金保障，随着项目产能释放与效益显现，公司盈利能力与经营业绩预计将实现显著提升。

#### 四、募集资金投资项目可行性结论

综上所述，本次募集资金投资项目围绕公司现有主营业务进行，项目符合国家相关产业政策及公司战略发展方向，具有良好的市场发展前景和经济效益。项目建成后，能够进一步提升公司的资产质量和盈利水平，增强公司核心竞争力和抗风险能力，促进公司持续健康发展。因此，本次募集资金投资项目建设具备可行性，符合公司及全体股东利益。

金安国纪集团股份有限公司

董事会

二〇二六年二月三日